

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60748-21**

QC 760100

Deuxième édition  
Second edition  
1997-04

---

---

**Dispositifs à semiconducteurs –  
Circuits intégrés –**

**Partie 21:  
Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés  
à couches et les circuits intégrés hybrides à couches  
sur la base des procédures d'homologation**

**Semiconductor devices –  
Integrated circuits –**

**Part 21:  
Sectional specification for film integrated circuits  
and hybrid film integrated circuits on the basis  
of the qualification approval procedures**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**S**

*For price, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	4
Articles	
1 Domaine d'application et objet .....	6
2 Généralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités pour les essais d'environnement .....	6
2.1 Références normatives .....	6
2.2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles .....	8
2.3 Informations à donner dans la spécification particulière .....	8
3 Procédures d'homologation.....	10
3.1 Modèles associés .....	10
3.2 Homologation .....	10
3.3 Niveaux d'assurance.....	18
3.4 Nouvelle présentation des lots refusés (contrôle lot par lot) .....	26
3.5 Etapes de fabrication dans une usine d'un fabricant agréé située dans un pays qui n'est pas membre de la CEI .....	28
4 Procédures d'essais et de mesures.....	28
5 Tableaux pour la méthode B .....	30
Tableaux	
1 Programme d'essai pour procédure d'homologation pour la méthode A .....	14
2 Niveaux d'assurance et critères d'acceptation pour l'homologation pour la méthode A	20
3 Niveaux d'assurance et critères d'acceptation pour le contrôle de conformité de la qualité pour la méthode A.....	22
4 Sélection .....	26
5 Programme d'essai pour la procédure d'homologation pour la méthode B.....	30
6 Niveaux d'assurance et critères d'acceptation pour procédure d'homologation pour la méthode B .....	34
7 Niveaux d'assurance et critères d'acceptation pour le contrôle de conformité de la qualité pour la méthode B.....	36

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	5
Clause	
1 Scope and object.....	7
2 General, preferred characteristics, ratings and severities for environmental tests .....	7
2.1 Normative references .....	7
2.2 Preferred ratings and characteristics .....	9
2.3 Information to be given in a detail specification .....	9
3 Qualification approval procedures .....	11
3.1 Structural similarity .....	11
3.2 Qualification approval .....	11
3.3 Assessment levels .....	19
3.4 Resubmission of rejected lots (for lot-by-lot inspection) .....	27
3.5 Manufacturing stages in a factory of an approved manufacturer in a non-IEC member country.....	29
4 Test and measurement procedures .....	29
5 Tables of method B .....	31
Tables	
1 Test schedule for qualification approval for method A.....	15
2 Assessment levels and acceptance criteria for qualification approval for method A....	21
3 Assessment levels and acceptance criteria for quality conformance inspection for method A.....	23
4 Screening.....	27
5 Test schedule for qualification approval for method B.....	31
6 Assessment levels and acceptance criteria for qualification approval for method B....	35
7 Assessment levels and acceptance criteria for qualify conformance inspection for method B.....	37

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – CIRCUITS INTÉGRÉS –

#### **Partie 21: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation**

##### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 60748-21 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1991 et constitue une révision technique.

Cette norme est une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47A/444/FDIS	47A/476/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### SEMICONDUCTOR DEVICES – INTEGRATED CIRCUITS –

#### **Part 21: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the qualification approval procedures**

#### FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60748-21 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991 and constitutes a technical revision.

This standard is a sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the qualification approval procedures.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47A/444/FDIS	47A/476/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

## DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – CIRCUITS INTÉGRÉS –

### Partie 21: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation

#### 1 Domaine d'application et objet

Cette spécification intermédiaire s'applique aux circuits intégrés à couches et aux circuits intégrés hybrides à couches, en tant que circuits catalogue ou construits à la demande dont la qualité est garantie sur les bases de procédures d'homologation.

L'objet de cette spécification est de prescrire des valeurs préférentielles pour les valeurs limites et les caractéristiques, de choisir dans la spécification générique les méthodes d'essai et de mesure appropriées, et de donner les exigences de contrôle à utiliser dans les spécifications particulières des circuits intégrés à couches et des circuits intégrés hybrides à couches, rédigées suivant cette spécification.

Le concept de valeurs préférentielles s'applique directement aux circuits catalogue mais pas nécessairement à ceux fabriqués à la demande.

Les exigences et les sévérités des essais prescrits dans les spécifications particulières se référant à cette spécification intermédiaire sont d'un niveau égal ou supérieur à celles de la présente spécification, des niveaux inférieurs ne sont pas autorisés.

Une ou plusieurs spécifications particulières cadres sont associées à cette spécification, chacune portant un numéro CEI. Une spécification particulière cadre, complétée conformément au paragraphe 2.3 de cette spécification, constitue une spécification particulière. De telles spécifications particulières sont utilisées pour l'octroi de l'homologation des circuits intégrés à couches et des circuits intégrés hybrides à couches et le contrôle de la conformité de la qualité en accord avec le Système IECQ.

NOTE – Pour les procédures d'essai deux alternatives sont possibles: Méthode A ou Méthode B; cependant il n'est pas autorisé de changer de méthode entre les essais de la méthode A ou de la méthode B.

En général la méthode A convient mieux aux circuits intégrés à couches passifs alors que la méthode B s'applique mieux aux circuits intégrés à couches à technologie à semiconducteurs.

#### 2 Généralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités pour les essais d'environnement

##### 2.1 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60748. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60748 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60063: 1963, *Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs*

## SEMICONDUCTOR DEVICES – INTEGRATED CIRCUITS –

### Part 21: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the qualification approval procedures

#### 1 Scope and object

This sectional specification applies to film integrated circuits and hybrid film integrated circuits, manufactured as catalogue circuits or as custom-built circuits whose quality is assessed on the basis of qualification approval.

The object of this specification is to present preferred values for ratings and characteristics, to select from the generic specification the appropriate tests and measuring methods and to give general performance requirements to be used in detail specifications for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits derived from this specification.

The concept of preferred values is directly applicable to catalogue circuits but does not necessarily apply to custom-built circuits.

Test severities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional specification are of equal or higher performance level, because lower performance levels are not permitted.

Associated with this specification are one or more blank detail specifications, each referenced by an IEC number. A blank detail specification which has been completed as specified in 2.3 of this specification forms a detail specification. Such detail specifications are used for the granting of qualification approval of film integrated circuits and hybrid film integrated circuits and quality conformance inspection in accordance with the IECQ system.

NOTE – For test procedures two alternatives are available: method A or method B. However, it is not permitted to change the methods between tests of method A, respectively B. In general, method A is more suitable for passive-component based film integrated circuits, whereas method B is more applicable to semiconductor integrated circuit technology based film integrated circuits.

#### 2 General, preferred characteristics, ratings and severities for environmental tests

##### 2.1 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60748. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60748 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60063: 1963, *Preferred number series for resistors and capacitors*

CEI 60748-20: 1988, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits Intégrés – Partie 20: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches*

CEI 60748-20-1: 1994, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits Intégrés – Partie 20: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches – Section 1: Exigence pour l'examen visuel interne*

IEC 60748-20: 1988, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits*

IEC 60748-20-1: 1994, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits – Section 1: Requirements for internal visual examination*